底部填充胶 KXS8410

产品简介

- 底部填充胶KXS8410是单一组份低温储藏加热固化的环氧树脂胶粘剂，广泛应用于芯片倒装工艺（Flip-Chip）中。它具有优异的流动性，对芯片、基板、互连凸块之间的间隙填充性高，在热循环中提供极高的可靠性。耐高温老化性能和绝缘性能，胶层具有良好的机械性能以及耐化学性、抗漏电性能，广泛用于电子线路板上部分电子元件的涂敷保护、粘接密封及加固。

典型性能

- 高附着力
- 适用多种基材
- 低CTE
- 绝缘性能优异

联系我们：
蒋丹萍152-6144-8356；张艳138-5168-3378；荣岩180-6607-5325；
田晓冰152-5095-2541；许飞艳132-7663-5250；杨慧子159-9624-3638

	测试项目	KXS8410	
固化前	外观	黑色	目视
	粘度（25℃，cp）	1480±600mPa•s	ASTM D 2196
	适用时间（25℃）	3天	-
	固化时间(130℃)	45min	-
	建议储存条件	@-5~-20 ℃ 6个月	
固化后	硬度 shore D	85	GB/T 2411-2008
	介电强度 KV/mm	≥20	ASTM D149
	体积电阻率 Ω.cm	$\geq 10^{15}$	GB/T 1410-2006
	弯曲强度MPa	100	GB/T 15022.2-2017
	密度g/cm³ @25℃	1.63±0.05	ASTM D 792
	剪切强度MPa	≥5.0	GB/T 7124
	导热系数W(m·k)	0.5	ASTM D 5470
	玻璃化转变温度	95℃	GB/T 19466.2
	CTE（Tg前）ppm	21	
	CTE（Tg后）ppm	115	
	耐温范围 ℃	-40～200	-

使用方法：

- 打开包装之前，确保包装完整、无破损、产品在使用期内。
- 从冰箱取出后，在解冻时将注射器垂直放置；回温至25℃，开封前务必清除水汽。
- 已使用的产品不可倒入未使用的原包装产品中，避免污染；解冻后的产品避免重新冻结。
- 建议使用本资料中推荐的固化工艺进行固化。

包装、储存与运输：

- 塑料管包装，10cc、30cc、55cc、200cc支装；
- 避免挤压、碰撞或硬划伤，防止高温、雨淋或阳光直射；
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

注意事项：

- 对于高强度的结构粘接，去除表面的污染物，如油漆，氧化膜，油、灰尘，脱模剂和所有其他表面污染物；
- 为获得更大的粘接强度，推荐双面涂胶并且材施工注意事项之间的粘接间隙在0.08-0.13mm之间；
- 固化过程中采用适当夹具并且保证不要产生粘接部件之间的相对位移，固化前清楚多余的余胶；
- 本品不可与强氧化剂类物质接触，应存放在儿童接触不到的地方；
- 本品对眼睛有刺激性，可能引起皮肤过敏，使用时请做好防护措施；如有不慎接触眼睛和皮肤，立即清水清洗，必要时，请立即就医。